**2015全球模流達人賽- 概念說明書**

**繳件說明:**

* 繳件格式: word檔。授權同意書簽名部分請務必簽名掃描成電子檔。
* 收件信箱：[talentawards@moldex3d.com](mailto:talentawards@moldex3d.com)
* 收件截止日：**2015年4月24日(五)**

**參賽團隊資料** (\*為必填欄位)

**\*公司/單位 名稱 **

**\*團隊組代表 姓名  職稱   
\* Email **

**\*主管/指導教授 姓名  職稱 **

**\* Email **

**團隊組員(一) 姓名  職稱 **

**團隊組員(二) 姓名  職稱 **

**團隊組員(三) 姓名  職稱 **

**團隊組員(四)**  **姓名  職稱 **

**作品資料** (所有欄位皆為必填)

**作品名稱**

****

**作品大綱**<請提供一段故事大綱來簡述作品構想>

***範例：****軸承襯套是軸承中重要的零組件，可以防止磨損，延長機件使用壽命。襯套的真圓度與尺寸是成型中的重點項目，需要嚴格控制，否則在運轉時會因吻合度不佳產生異音，導致良率下降，而主宰整體成型真圓度與尺寸變形的關鍵為融膠流動平衡與肉厚設計。光寶科技使用Moldex3D 模流分析軟體，針對肉厚設計與澆口位置進行優化，成功改善產品不良問題，並提高產品良率。*****

**使用產品/模組** <請簡述作品使用Moldex3D的哪些產品或是模組>

****

**挑戰/目標 <**請描述需要解決的挑戰或是預計達成的目標>

*範例： 電子連結器件在射出成型過程中往往會遇到一些問題，材料方面選用玻纖來增強強度，多材質射出則增添結合難度，配合件間的間隙需要高精密度的公差。*

****

**解決方案** <請描述是如何使用Moldex3D克服挑戰或是協助達成目標>

***範例：****Extreme Tool & Engineering 採用*[*Moldex3D eDesign*](http://www.moldex3d.com/ch/products/edesign)*射出成型模擬軟體，準確預測問題並進行設計優化，在實際生產前即利用虛擬試模，讓潛在問題立即獲得解決，節省修復帶有瑕疵產品所支出的時間和經費*

****

**具體效益** <請描述哪方面獲得了顯著改善或是描述價值>

***範例：****產品凹痕消除/有效控制縫合線位置，防止產品斷裂等問題/符合產品尺寸精度要求/產品縮水率大幅改善45-60%/產品平整度大幅改善40-50%*

****

**概念完整說明**<請在此完整描述作品的概念、執行過程及結果>

***範例：***<http://www.moldex3d.com/ch/customer-success/moldex3d-3d-gas-assisted-simulation-helps-lite-on-technology-enhance-dimensional-stability>

****

**參賽作品著作權授權及刊登同意書**

本人及本人代表團隊\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下簡稱本人)

因參加科盛科技股份有限公司（以下簡稱科盛科技）主辦之「2015 Moldex3D全球模流達人賽」(以下簡稱本活動)，同意以下本活動參賽辦法及規定，並授予科盛科技以下權利:

1. 本人擁有完全權利與權限簽署並履行本同意書，且已取得簽署本同意書必要之第三者同意與授權。
2. 本人茲同意將所有繳交本活動的參賽作品(含概念說明書、成果報告書、CAD模型)等內容，不限載體、用途、使用次數、地區、期間，包含但不限於散布、重製、發行、改作、翻譯、再授權、公開傳輸、公開展示、公開播送與公開發表之權，永久無償授權科盛科技及其國內外關係企業及其授權之第三方，提供大眾進行檢索、瀏覽、下載、傳輸、列印及公開使用等。
3. 本同意書為專屬授權。本人保證未侵害或抄襲他人之著作，且未曾參加其他競賽得獎，特此聲明。本作品作者若有違反上開情事，願被取消資格及敘獎；本人作品若有侵害他人權利或涉及違法，本人願負全部之賠償責任。若因此致科盛科技受有損害，並願負賠償責任。
4. 如違反本同意書各項規定，本人須自負法律責任，科盛科技並得要求參賽人返還全數獎金。
5. 作品及本同意書內容範圍內，因可歸責於本人之事由致本主辦單位受有損害，本人應負賠償科盛科技之責。
6. 科盛科技保留修改、暫停或終止本活動辦法及修正獎項數量之權利。

此致 科盛科技股份有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| **立同意書人 (本人)** | |
| 本人已了解並同意上述內容  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 簽章** | |
|  |  |
| **主管/指導教授** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 簽章** |  |
| **中華民國 年 月 日** |  |